

# 2018年3月期（2017年4月～2018年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2018年4月25日

内容：

- 2018年3月期 連結決算の概要                      経理部長                      笹川 謙
- 事業環境および業績予想                      代表取締役社長・CEO                      河合 利樹



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

- ガートナーのデータについて（17ページ）

本プレゼンテーションにおいてガートナーに帰属するすべての記述は、ガートナーの顧客向けに発行された配信購読サービスの一部として発行されたデータ、リサーチ・オピニオン、または見解に関する東京エレクトロンによる解釈であり、ガートナーによる本プレゼンテーションのレビューは行われておりません。ガートナーの発行物は、その発行時点における見解であり、本プレゼンテーション発行時点のものではありません。ガートナーの発行物で述べられた意見は、事実を表現したものではなく、事前の予告なしに変更されることがあります。

FPD:フラットパネルディスプレイ

# 2018年3月期 連結決算の概要

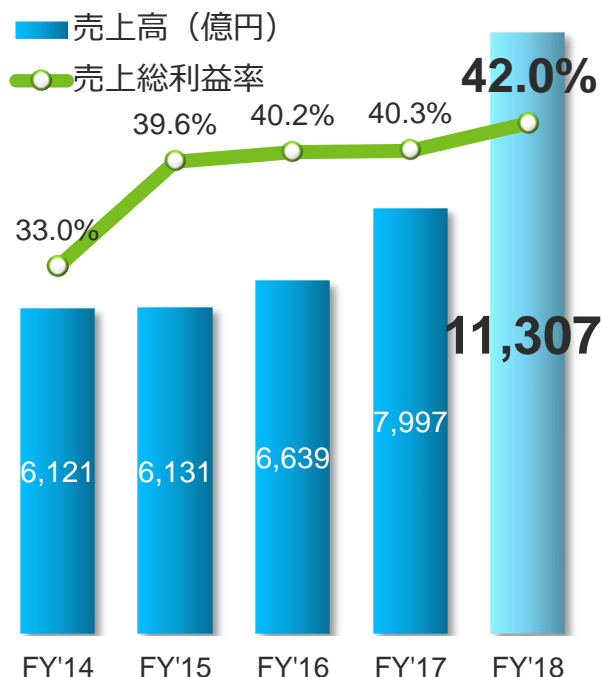
2018年4月25日

笹川 謙  
経理部長

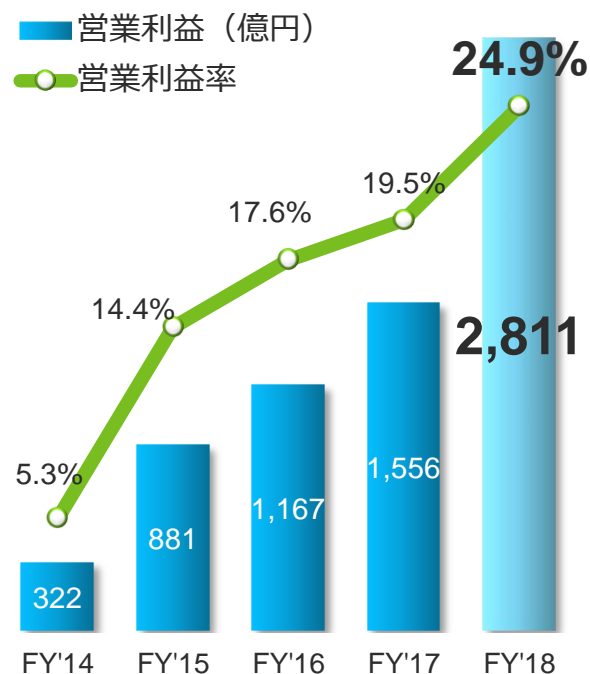


# FY2018（2017年4月～2018年3月）ハイライト

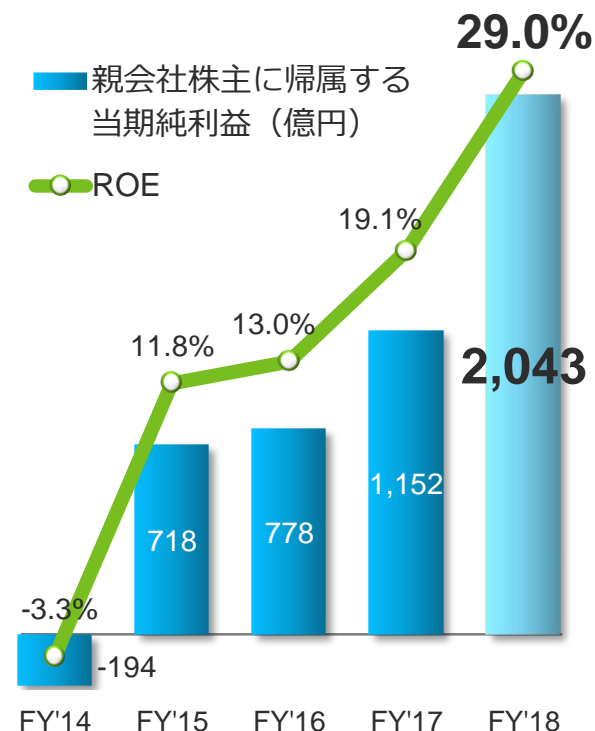
## 売上高と売上総利益率



## 営業利益と営業利益率



## 親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



- SPE\*需要の拡大と注力分野におけるシェア拡大により、前期比+41%の増収
- 営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益が過去最高を大きく更新

# 損益状況（四半期）

(億円)

	FY2017	FY2018				対Q3 増減率
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	2,606	2,363	2,805	2,577	3,559	+38.1%
SPE	2,435	2,219	2,657	2,414	3,260	+35.1%
FPD	170	143	147	162	297	+83.1%
売上総利益	1,106	971	1,182	1,060	1,535	+44.8%
下段：売上総利益率	42.5%	41.1%	42.1%	41.1%	43.1%	+2.0pts
販管費	491	423	497	479	537	+12.1%
営業利益	615	547	685	580	997	+71.7%
下段：営業利益率	23.6%	23.2%	24.4%	22.5%	28.0%	+5.5pts
税金等調整前当期純利益	614	551	671	573	956	+66.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	472	412	494	407	729	+79.3%
研究開発費	248	211	248	239	270	+13.1%
設備投資額	71	81	117	137	120	-12.7%
減価償却費	50	42	47	55	60	+10.6%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



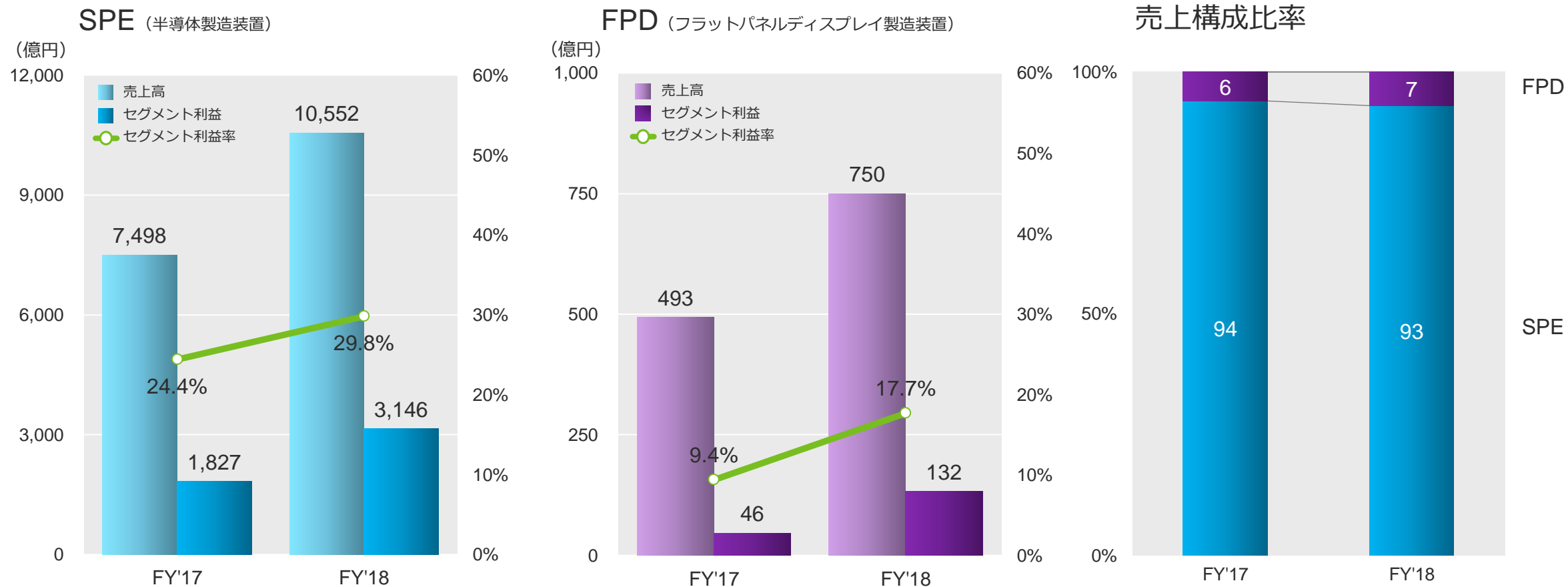
# 損益状況

(億円)

	FY2017	FY2018	対前年 増減率	(ご参考) 2017年10月31日発表 のFY2018予想
売上高	7,997	11,307	+41.4%	11,300
SPE	7,498	10,552	+40.7%	10,547
FPD	493	750	+52.0%	750
売上総利益	3,222	4,750	+47.4%	4,670
下段：売上総利益率	40.3%	42.0%	+1.7pts	41.3%
販管費	1,665	1,938	+16.4%	1,960
営業利益	1,556	2,811	+80.6%	2,710
下段：営業利益率	19.5%	24.9%	+5.4pts	24.0%
税金等調整前当期純利益	1,491	2,752	+84.6%	2,670
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	2,043	+77.4%	1,980
1株当たり当期純利益 (円)	702.26	1,245.48	+77.4%	1,206.66
研究開発費	838	971	+15.9%	1,000
設備投資額	206	456	+120.3%	500
減価償却費	178	206	+15.4%	230

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# セグメント情報

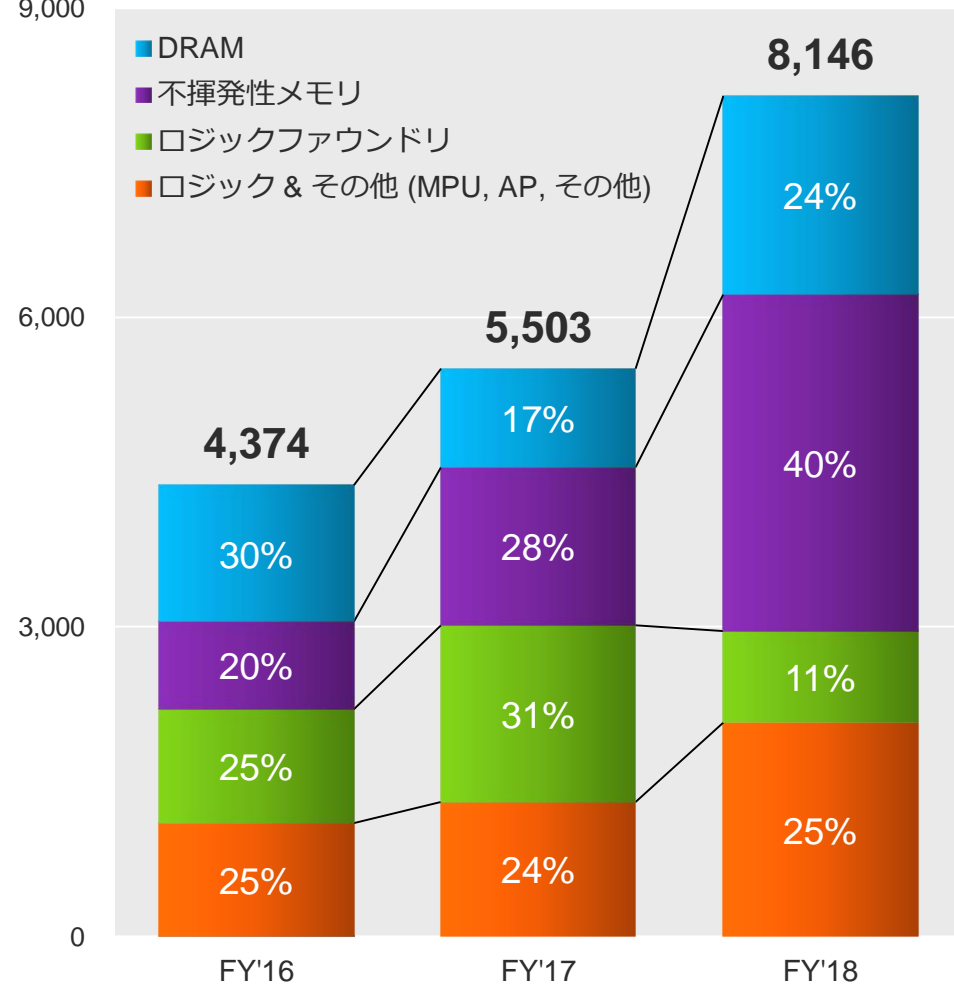


## SPE・FPDともに収益性が大幅に向上

1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

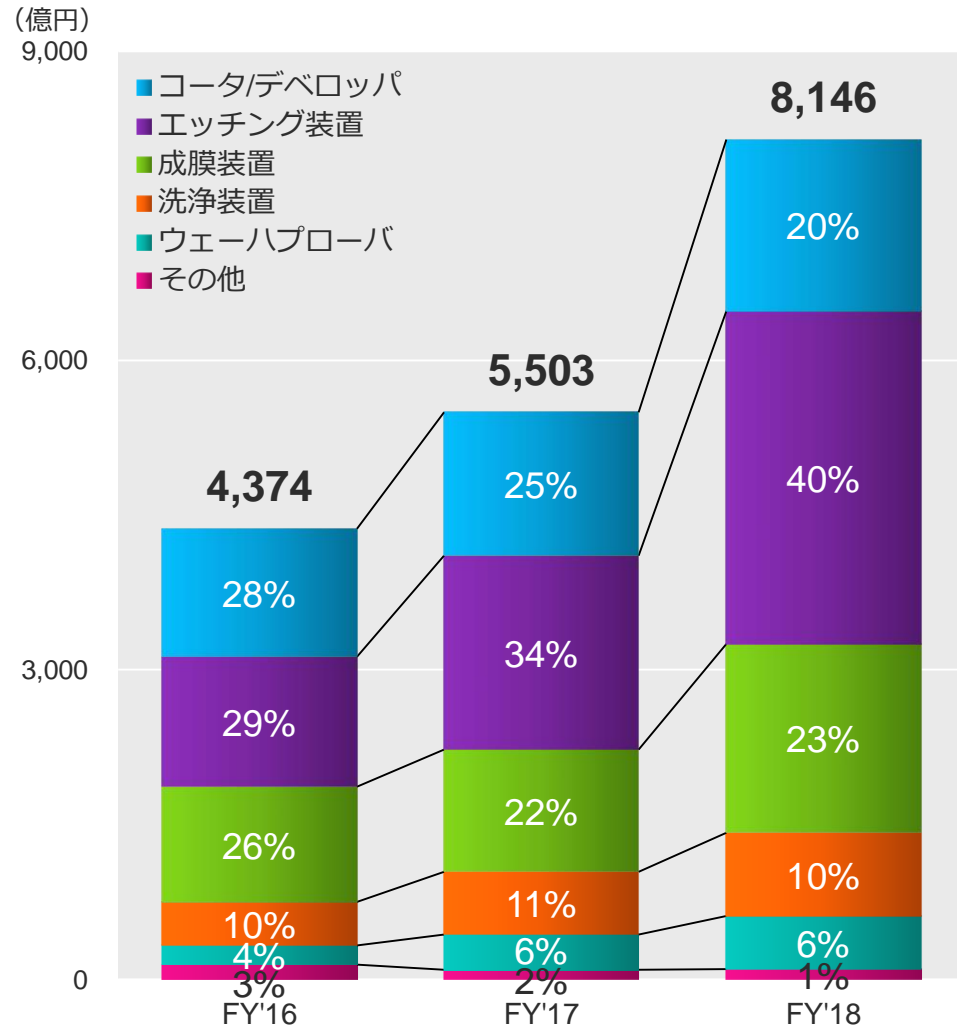
(億円)  
9,000



- サーバ需要や次世代技術への積極的な投資を背景に、DRAM・不揮発性メモリ向けの売上が前期比2倍以上に拡大
- ファウンドリ/ロジック向けにおいても、最先端の世代に加え、28nm以前への投資が継続

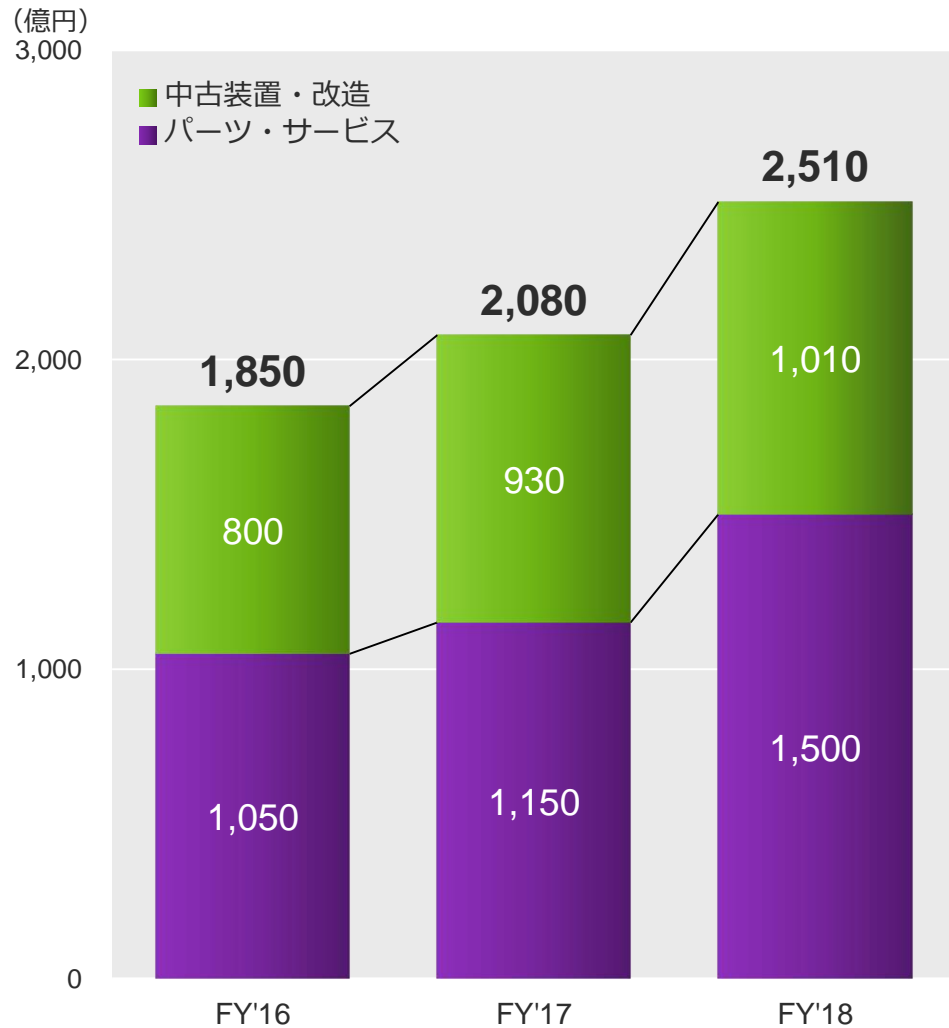


# SPE部門 新規装置 製品別売上構成比



- 不揮発性メモリ・マルチプルパターンニングによる微細化への投資を背景に、当社注力分野（エッチ・成膜・洗浄）の売上が拡大

# フィールドソリューション売上高

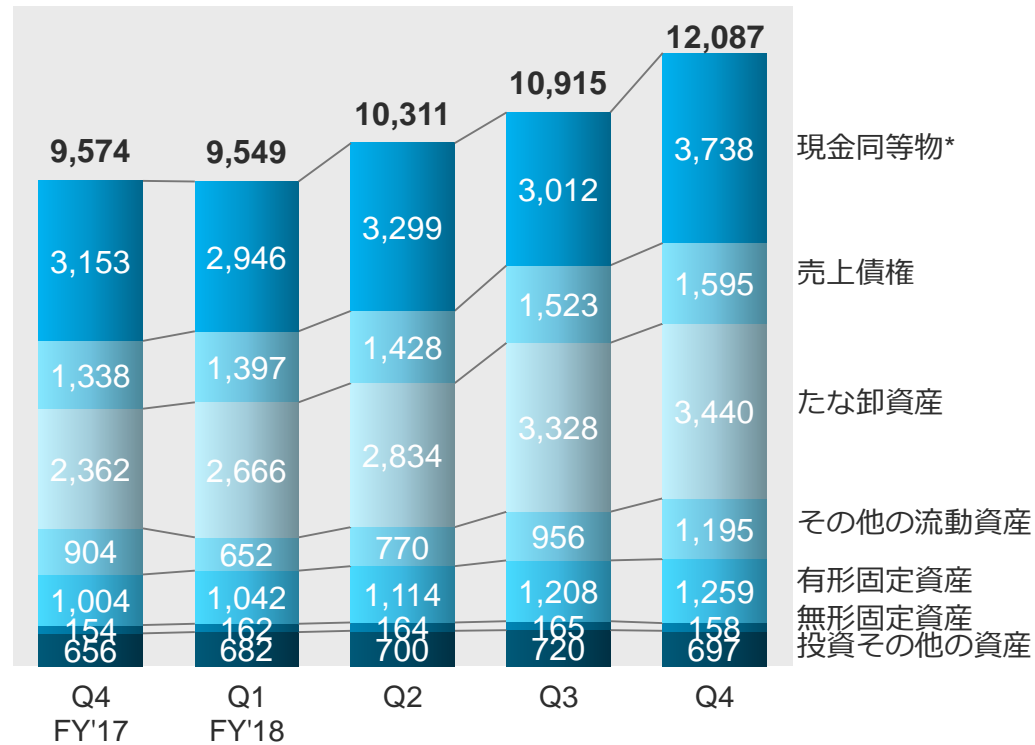


- 売上は前期比+21%伸長し、通期 2,510億円
- 顧客の稼働率上昇により、パーツ販売が韓国を中心に大きく伸長

# 貸借対照表 (四半期)

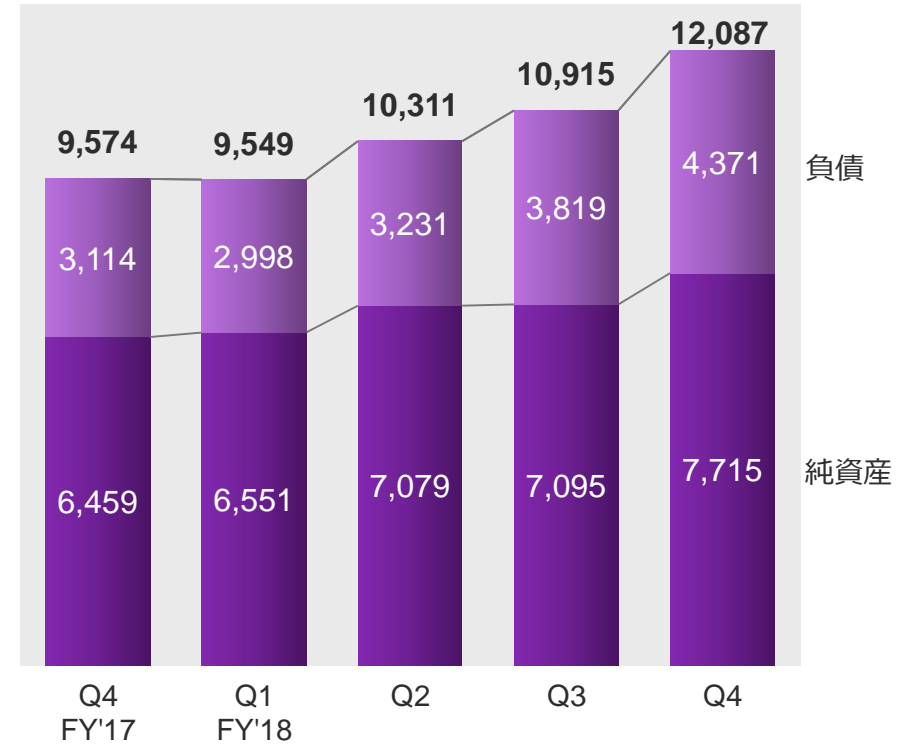
## 資産

(億円)



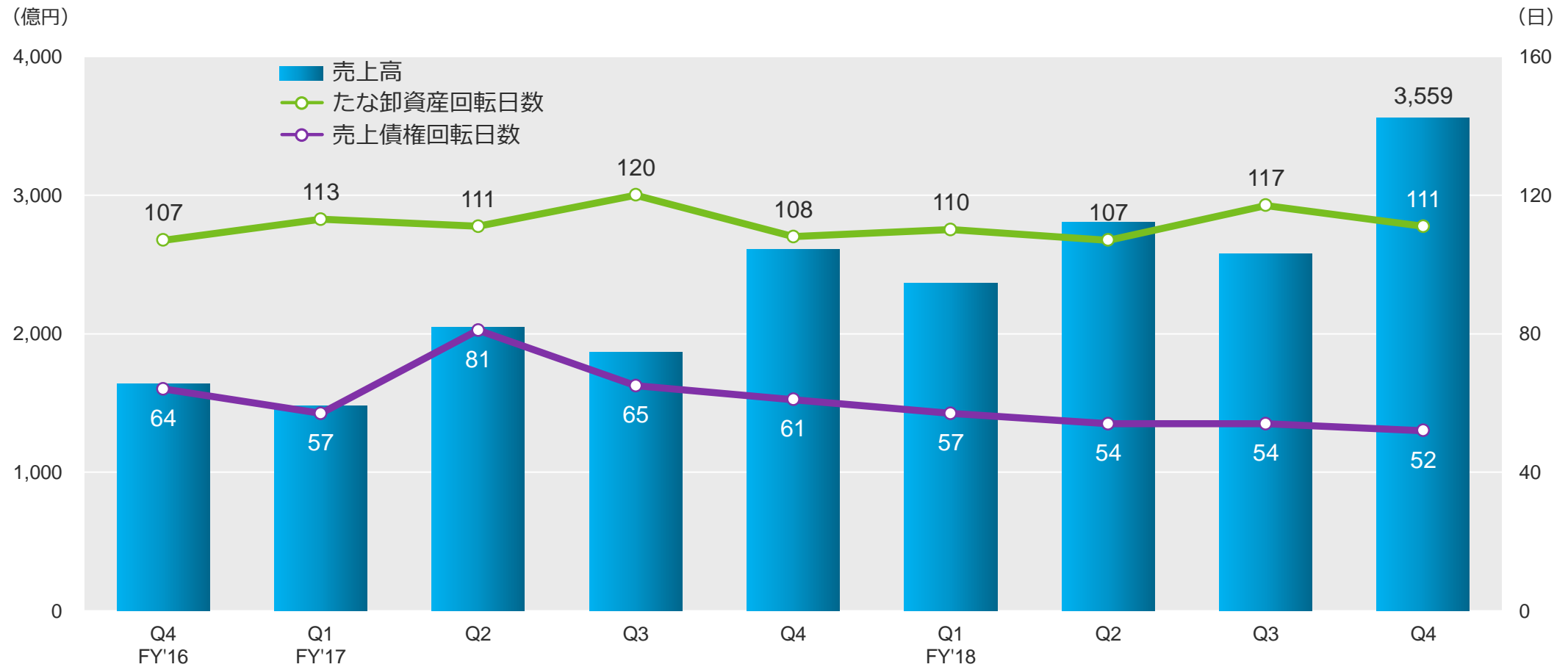
## 負債・純資産

(億円)



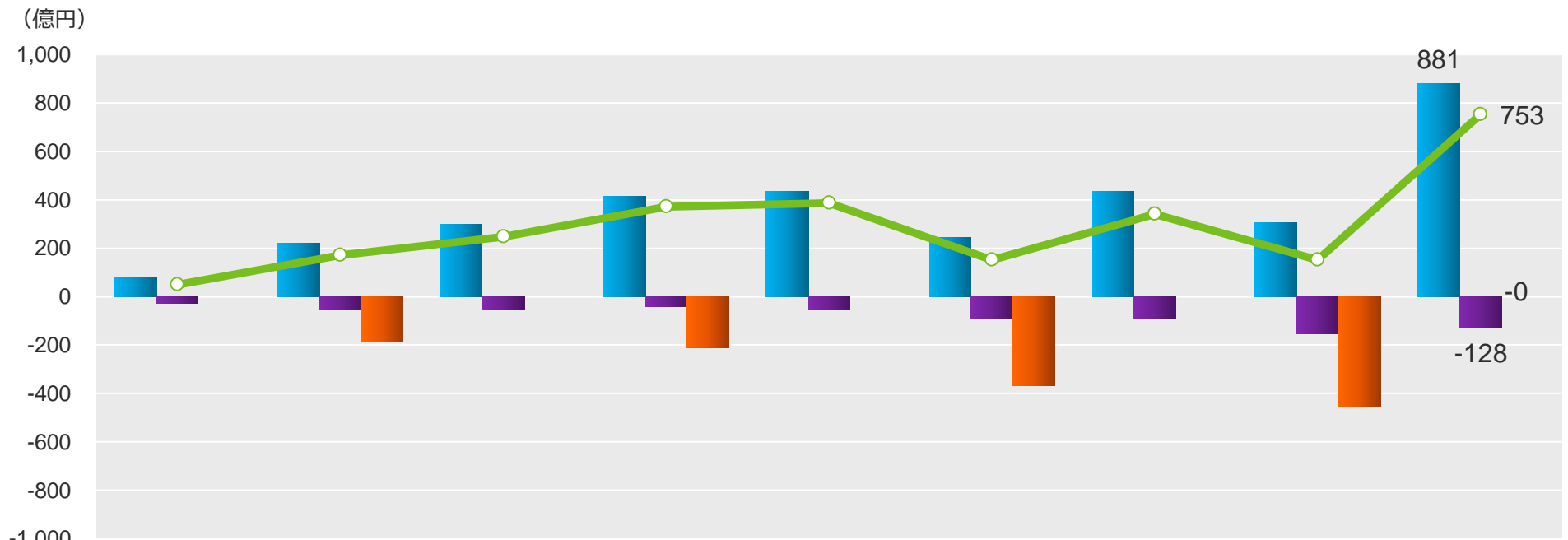
\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー（四半期）



	Q4 FY'16	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4
営業キャッシュ・フロー	79	221	298	413	436	244	434	304	881
投資キャッシュ・フロー*	-29	-49	-49	-41	-49	-93	-94	-152	-128
財務キャッシュ・フロー	0	-183	0	-210	-0	-368	-0	-457	-0
フリーキャッシュ・フロー**	50	172	248	371	387	151	340	151	753
手元資金残高***	2,366	2,309	2,556	2,772	3,153	2,946	3,299	3,012	3,738

\* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

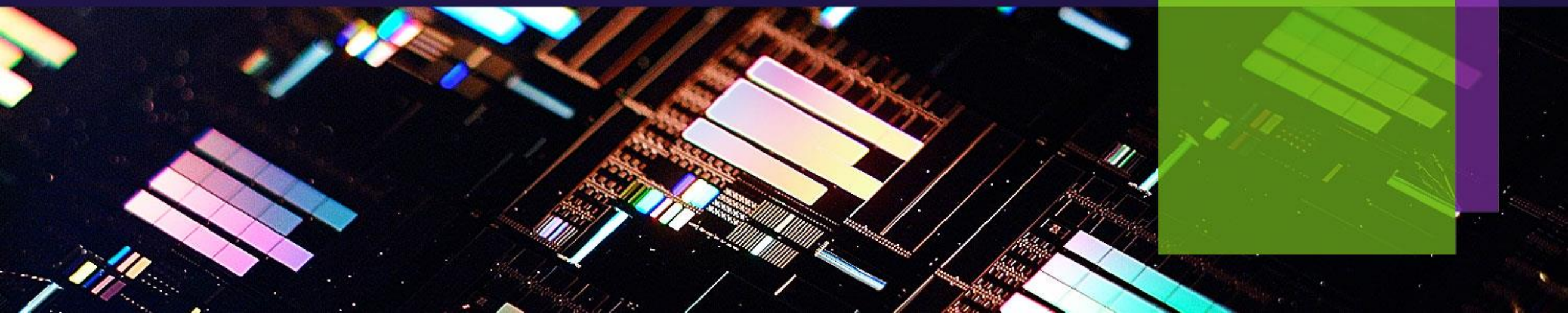
\*\* フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

\*\*\* 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

# 事業環境および業績予想

2018年4月25日

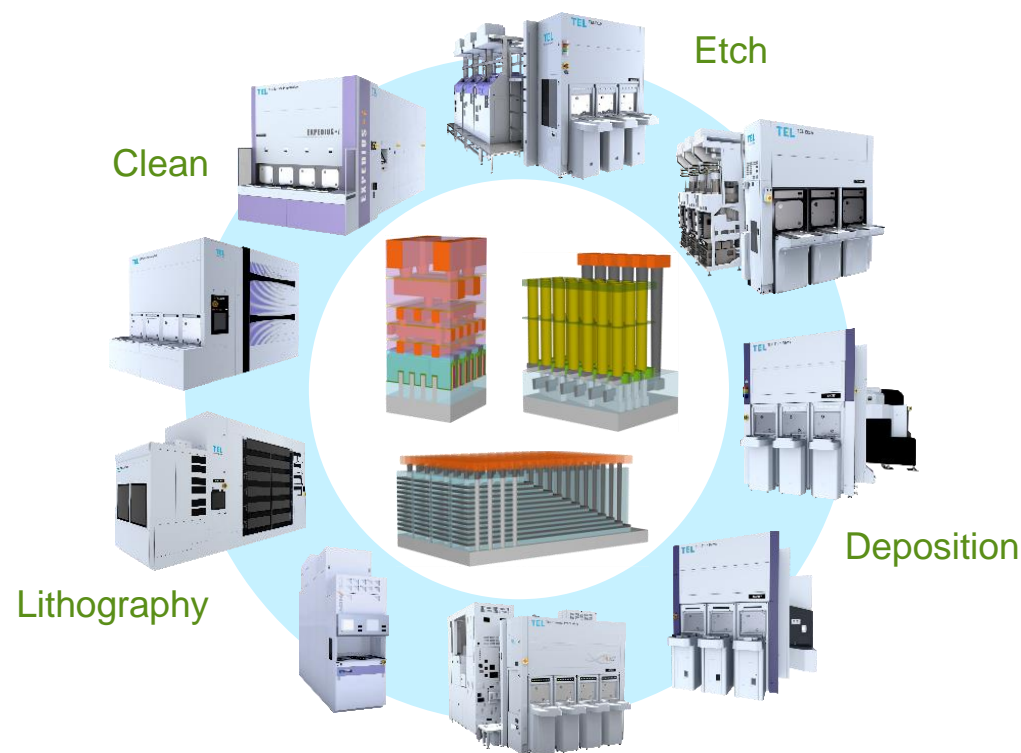
河合 利樹  
代表取締役社長・CEO





# FY2018 SPE事業のハイライト

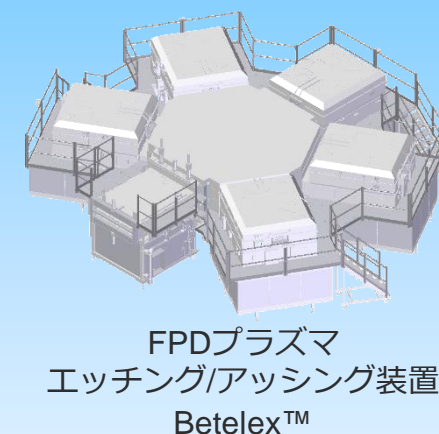
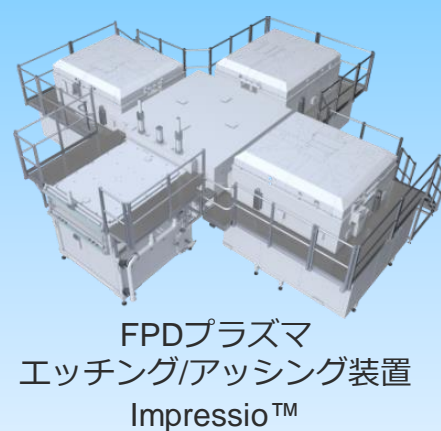
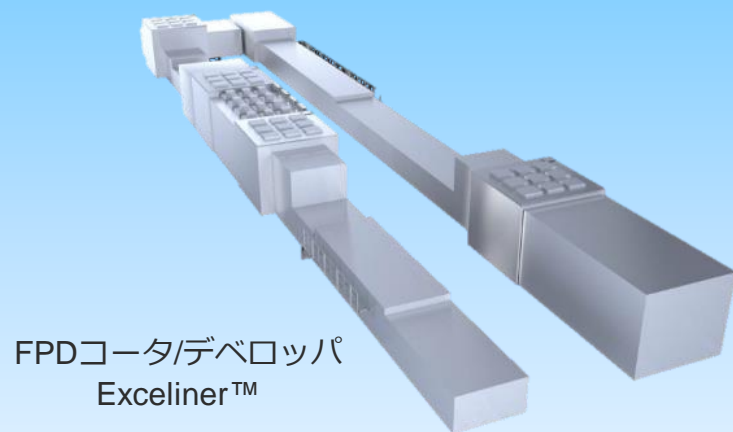
- 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズの設立
- 顧客協業によりプロセスインテグレーションのソリューション開発が加速
- 戦略製品による収益向上
- 宮城工場（エッチング装置）の拡張
  - 新物流棟の稼働開始
  - 新開発棟の着工（9月竣工予定）



SPEの事業戦略は計画通り進捗、次世代向け技術で収益拡大

# FY2018 FPD事業のハイライト

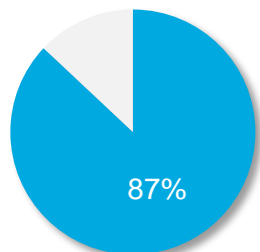
- 第10.5世代におけるリーディングポジション確立
- 新プラットフォーム エッチング装置 Betelex™を投入
- PICP™\*エッチング装置の製品展開が順調



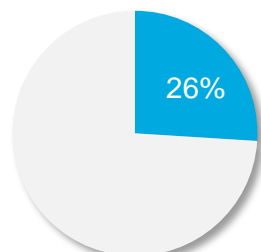
中期目標の営業利益率20%以上に向かって計画通り進捗

# TEL 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2017)

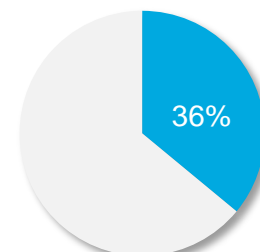
## 半導体製造装置



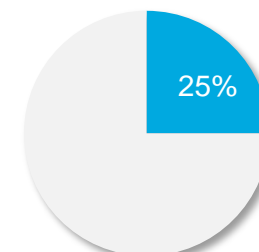
コータ/デベロッパ



ドライエッチング装置

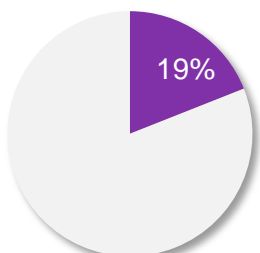


成膜装置

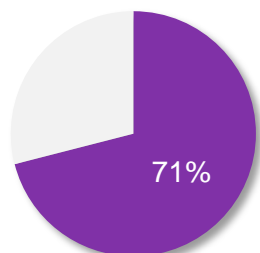


洗浄装置

## FPD製造装置 (FY2018)

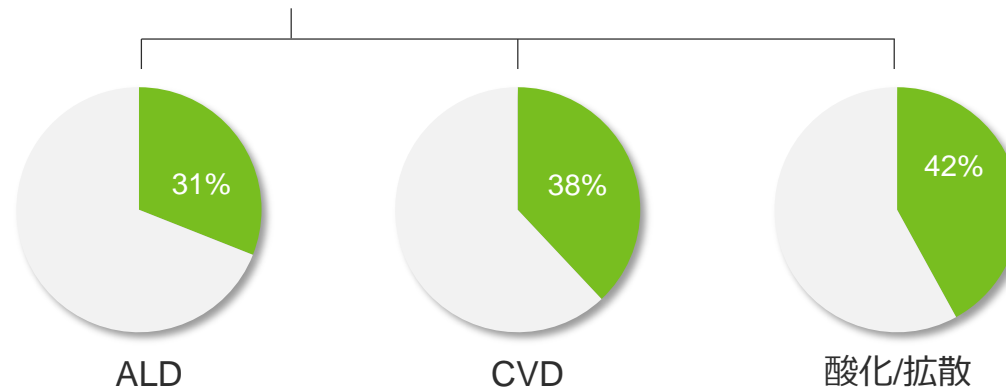


FPDコータ/デベロッパ



FPDプラズマエッチング装置

出所(FPD): 当社推定



出所(SPE): Gartner, "Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2017", 18 April 2018, 図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。

コータ/デベロッパ: Photoresist processing (Track), ドライエッチング装置: Dry etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic layer deposition tools + Oxidation/diffusion furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic layer deposition tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/diffusion, 洗浄装置: Wet stations + Spray processors + Other clean process

# 半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

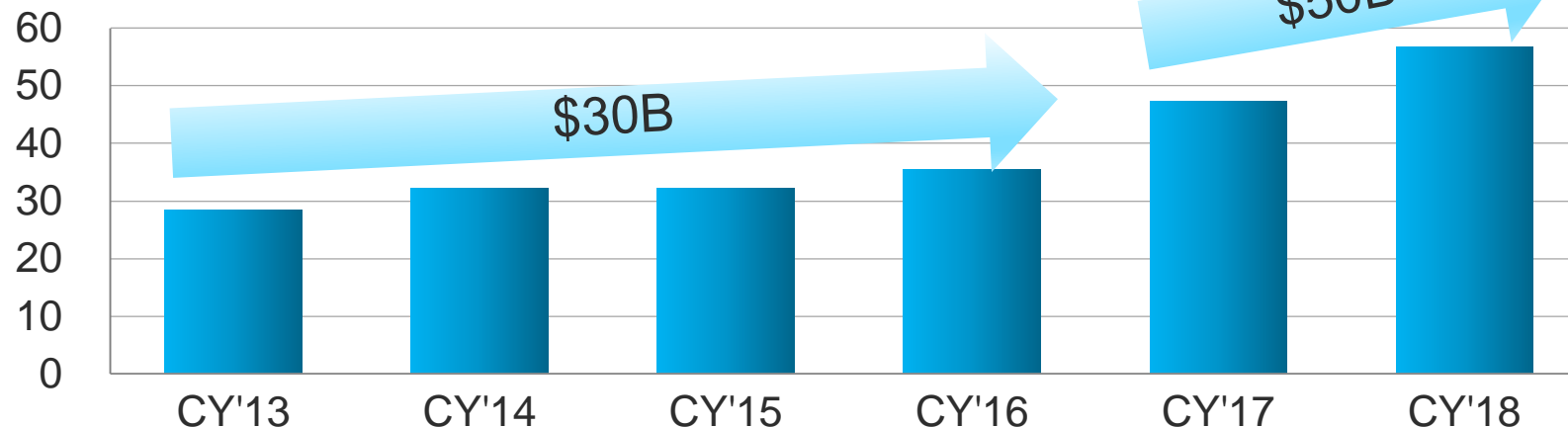
## 将来の成長ドライバー

PC・インターネット・モバイル  
+  
VR/AR/MR\*・IoT・AI・RPA\*\*・機械学習  
ビッグデータ・自動運転・ブロックチェーン

WFE市場の成長加速  
\$50B以上へ拡大

\*VR/AR/MR：仮想現実/拡張現実/複合現実 \*\*RPA：ロボットによる処理自動化

(\$ Billion)



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

## 事業環境（2018年4月時点での見方）

### ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)\* の設備投資

CY2018の投資額は、旺盛なメモリ向け需要に牽引され、前年比15%程度の成長を見込む。

### ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程\*\* 向け設備投資

CY2018の装置需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資は調整も、大型パネルの需要増加により第10.5世代向けの投資が大きく拡大し、前年比10%程度の成長を予想。

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

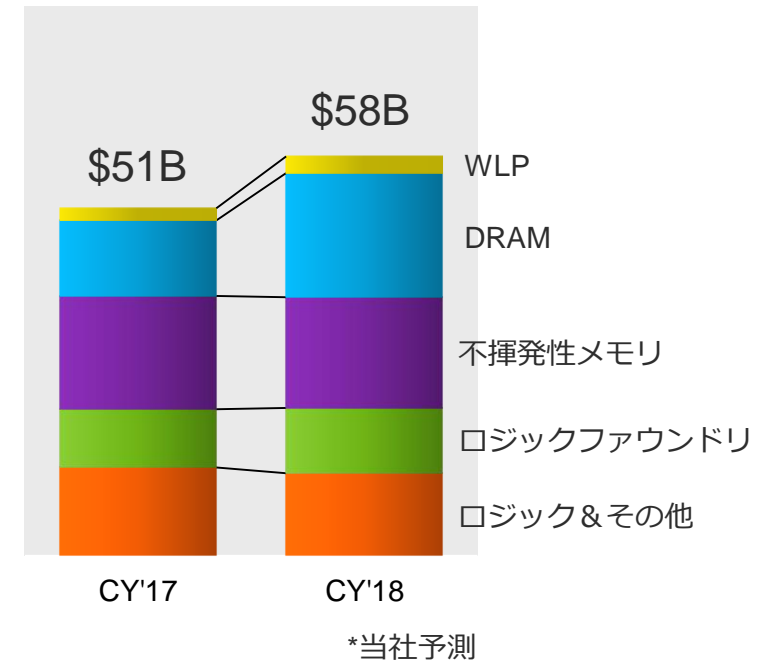
\* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*\* TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

# CY2018 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- DRAM：前年比60%増加
  - 設備投資：投資額の7割が新規工場向け、また8割が1X/1Ynm世代向け
  - 牽引役：サーバの平均搭載容量は前年比35%増加
  - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- 不揮発性メモリ：同水準
  - 設備投資：最先端の9X層数世代向けが5割
  - 牽引役：データセンタ・PC向けSSD需要の拡大
  - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準
  - 設備投資：10nm以細の世代向けが5割
  - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
  - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

アプリケーション別WFE市場\*





# FY2019 業績予想

# FY2019 業績予想

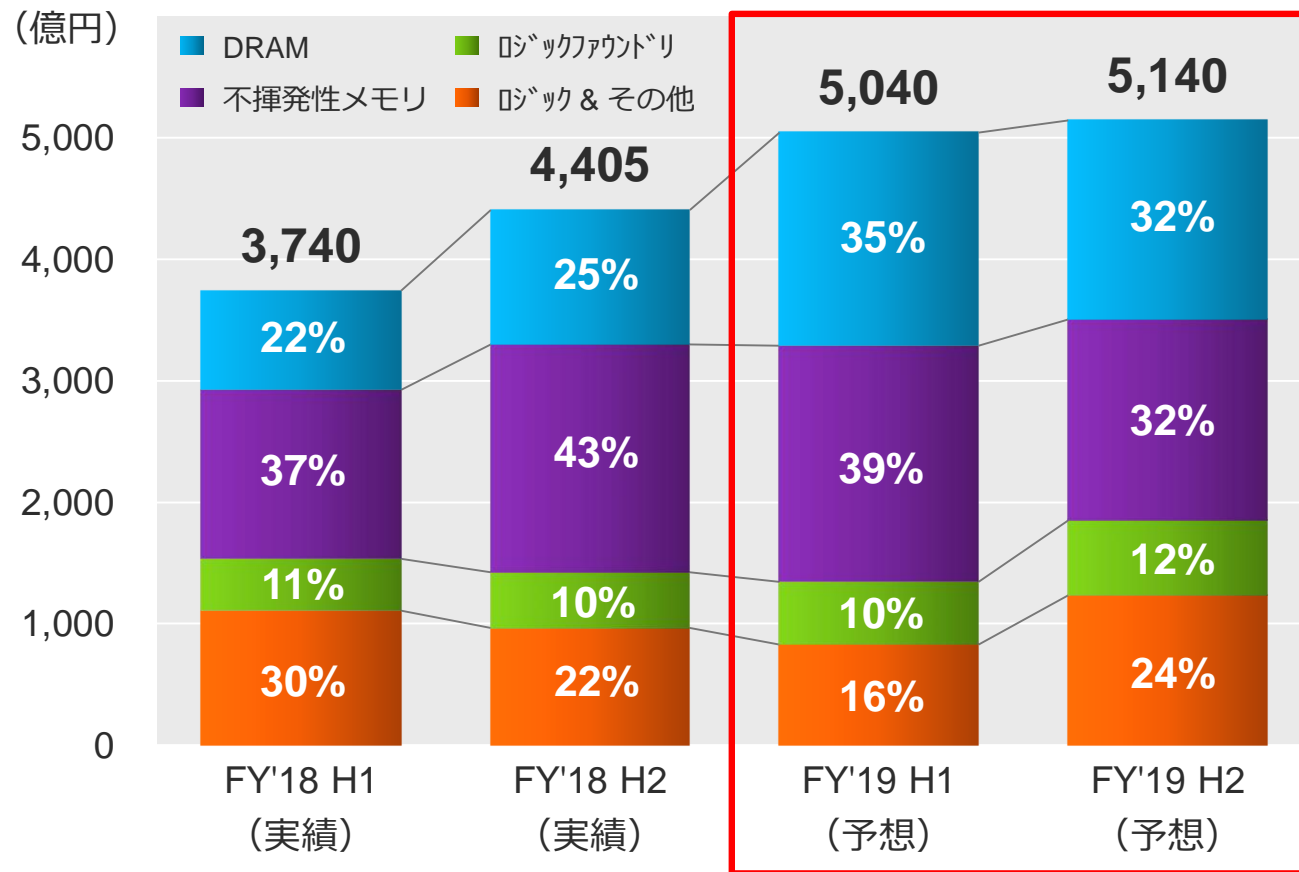
(億円)

	FY2018 (実績)	FY2019 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	11,307	6,900	7,100	14,000	+23.8%
SPE	10,552	6,340	6,540	12,880	+22.1%
FPD	750	560	560	1,120	+49.2%
売上総利益	4,750	2,880	3,100	5,980	+1,229
下段：売上総利益率	42.0%	41.7%	43.7%	42.7%	+0.7pts
販管費	1,938	1,150	1,170	2,320	+381
営業利益	2,811	1,730	1,930	3,660	+848
下段：営業利益率	24.9%	25.1%	27.2%	26.1%	+1.2pts
税金等調整前当期純利益	2,752	1,730	1,930	3,660	+907
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,043	1,280	1,420	2,700	+656
1株当たり当期純利益 (円)	1,245.48	779.95	-	1,645.20	+399.72

市場成長以上の売上拡大、3期連続の過去最高益を見込む

# FY2019 SPE部門 新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比

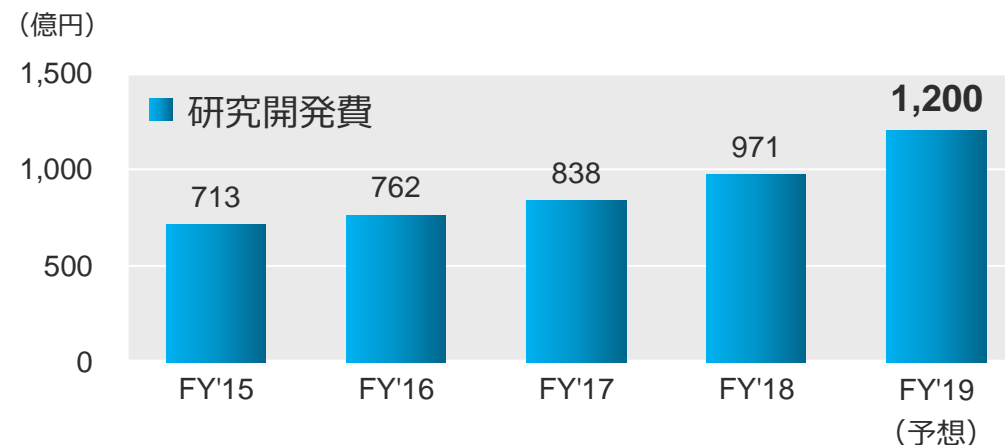


- DRAM
  - 需給タイトにより投資拡大
- 3D NAND
  - データセンタ・PC向けSSD需要で、堅調な投資継続
- ロジック/ファウンドリ
  - 10/7nm世代への投資継続
  - 28nm世代以前への投資も堅調

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

# FY2019 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,200億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 510億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 260億円



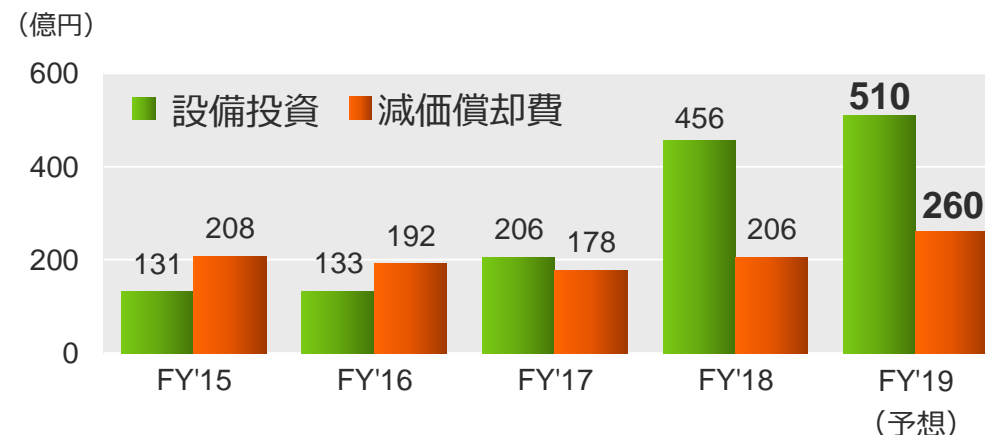
新生産棟の建設  
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士吉田市：建設費約130億円  
(2019年1月着工、2020年4月竣工予定)

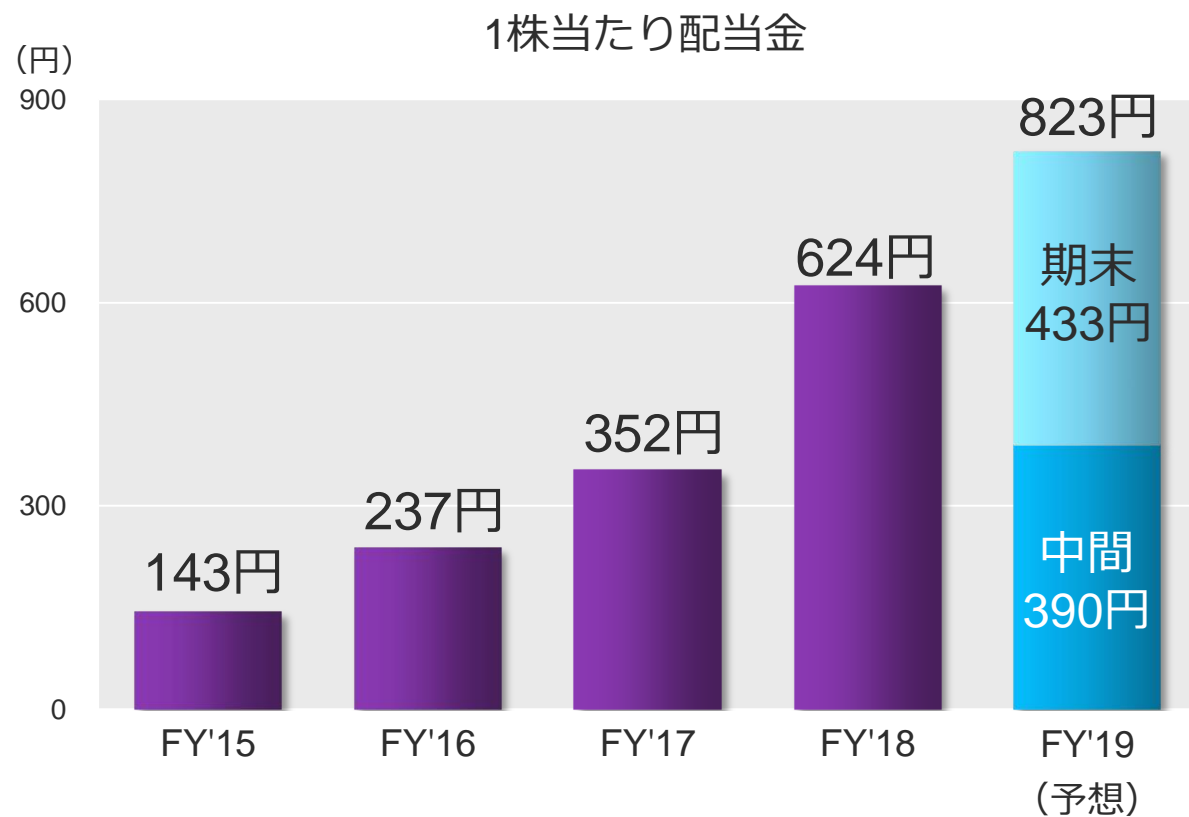


岩手県奥州市：建設費約130億円  
(2018年10月着工、2019年9月竣工予定)



成長フェーズにある装置市場で事業機会を最大化

# FY2019 配当予想



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

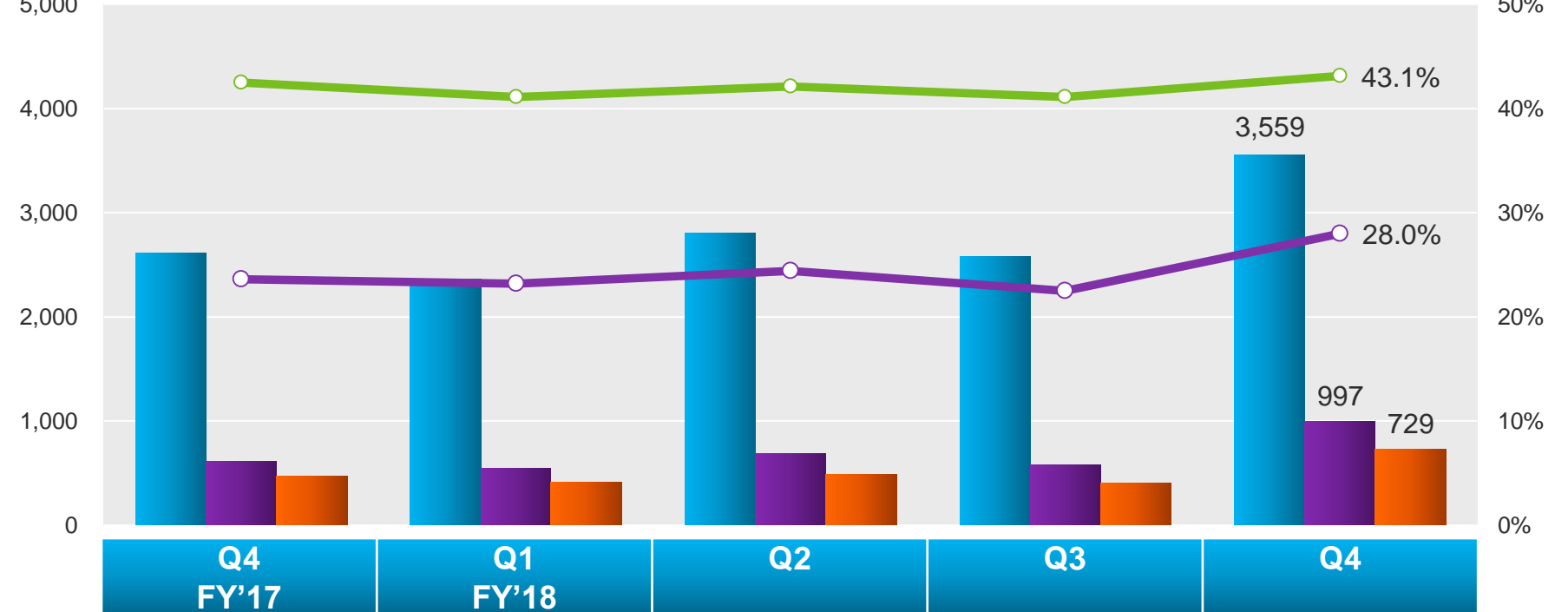
1株当たり配当金は、前期比32%の増配を予定

# 補足資料



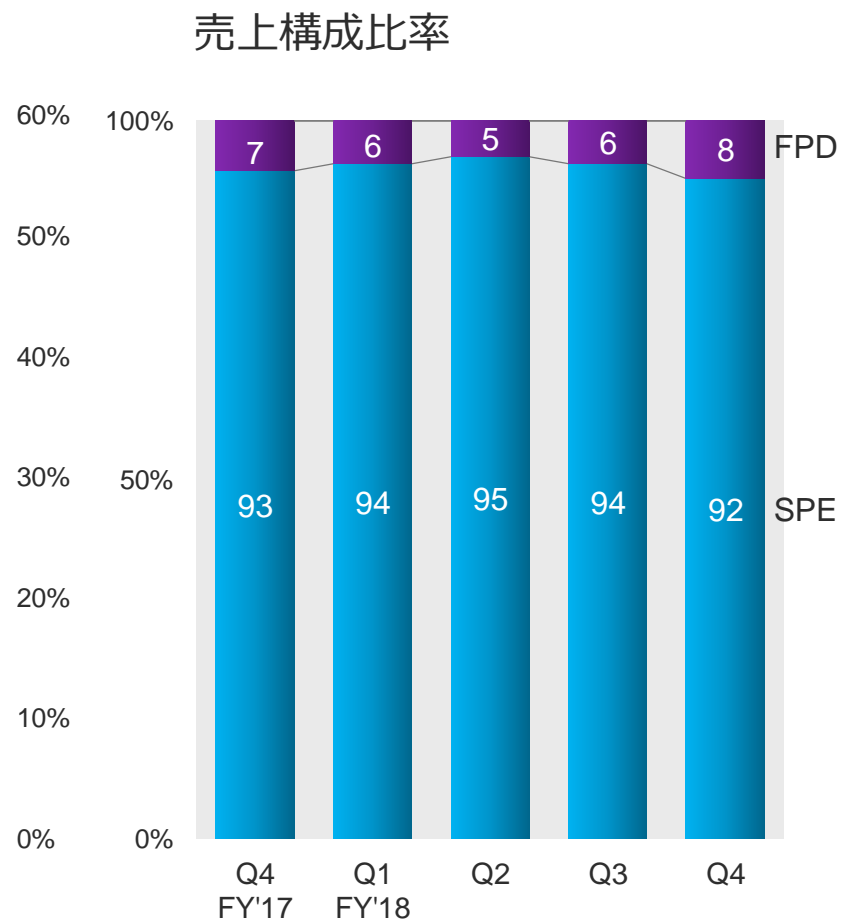
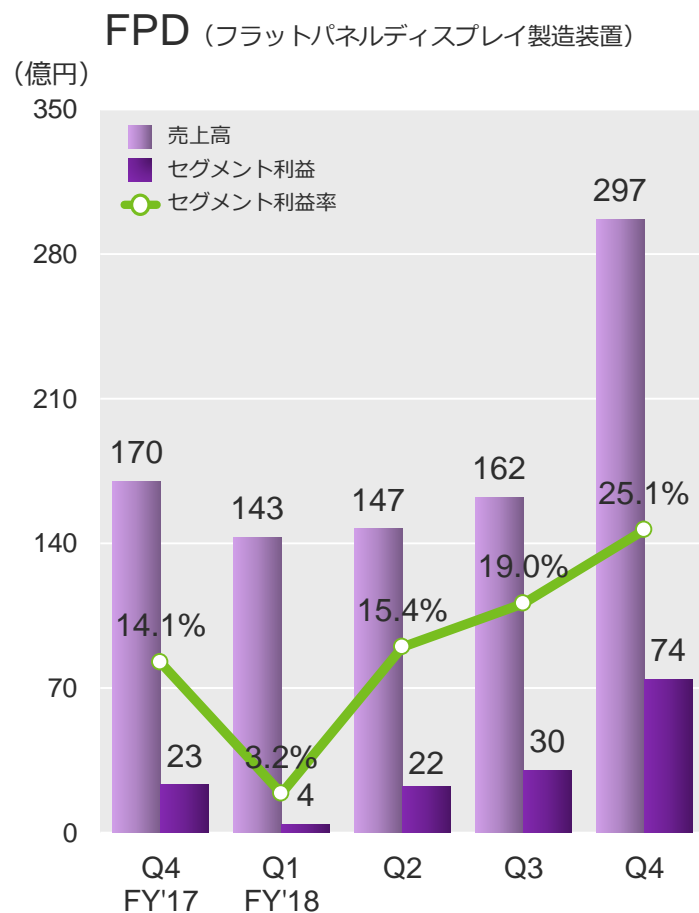
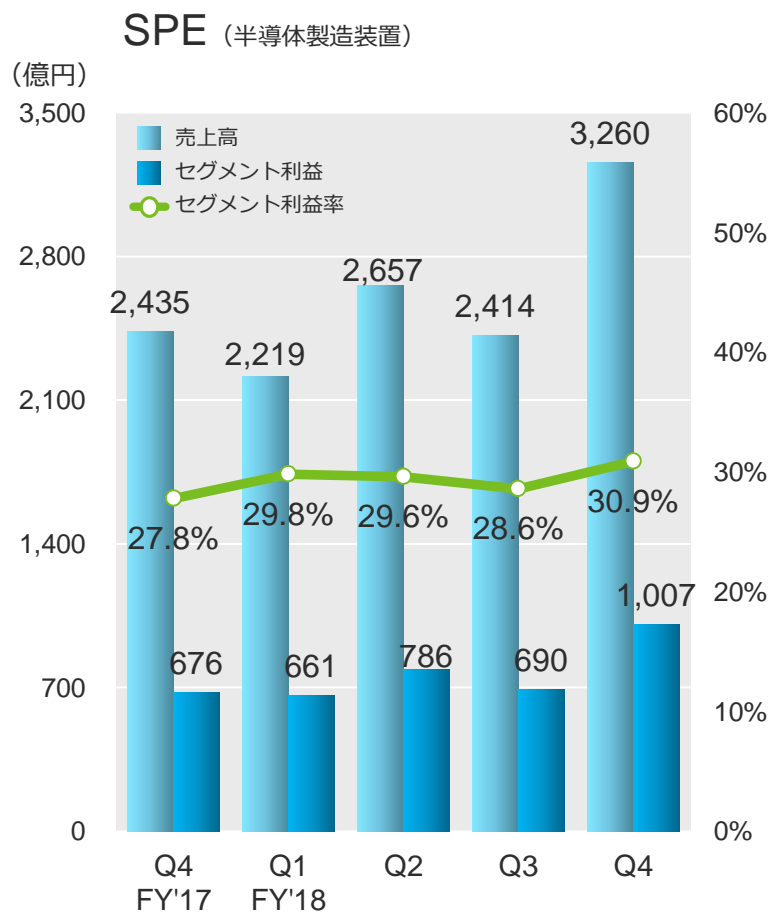
# 損益状況 (四半期)

(億円)  
5,000



■ 売上高	2,606	2,363	2,805	2,577	3,559
■ 営業利益	615	547	685	580	997
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	472	412	494	407	729
○ 売上総利益率	42.5%	41.1%	42.1%	41.1%	43.1%
○ 営業利益率	23.6%	23.2%	24.4%	22.5%	28.0%

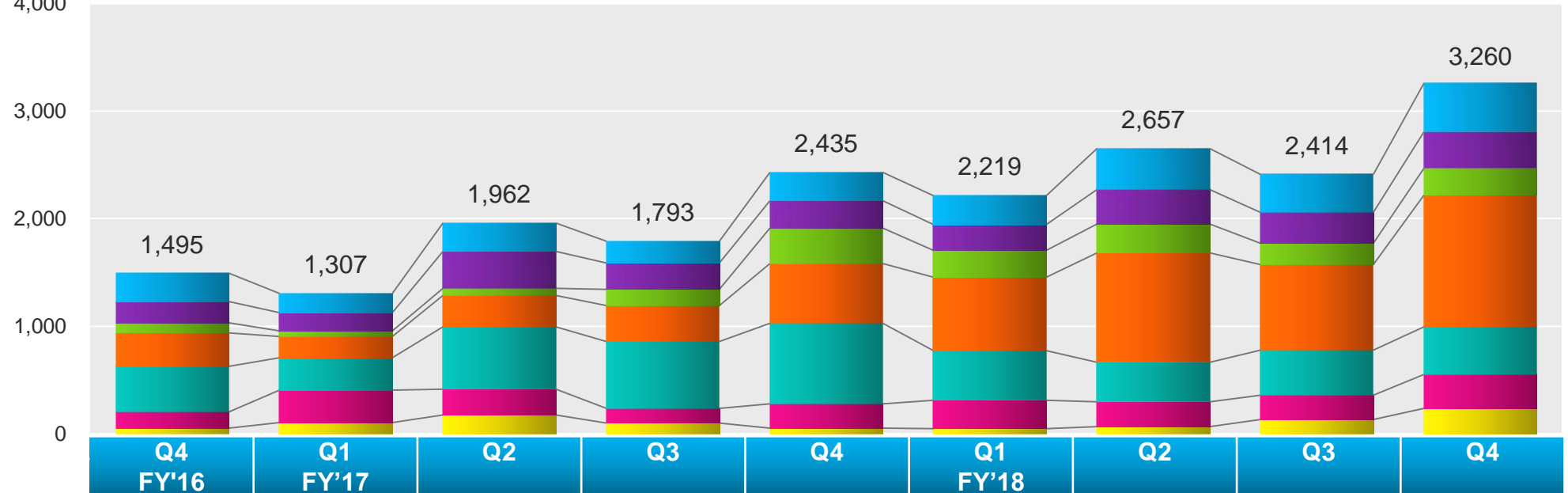
# セグメント情報（四半期）



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

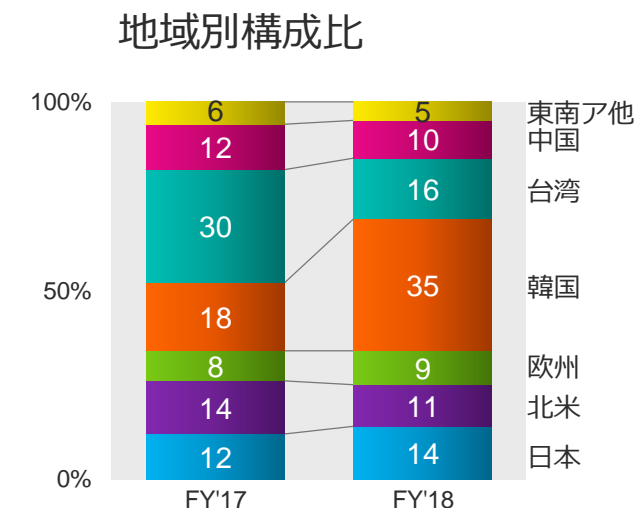
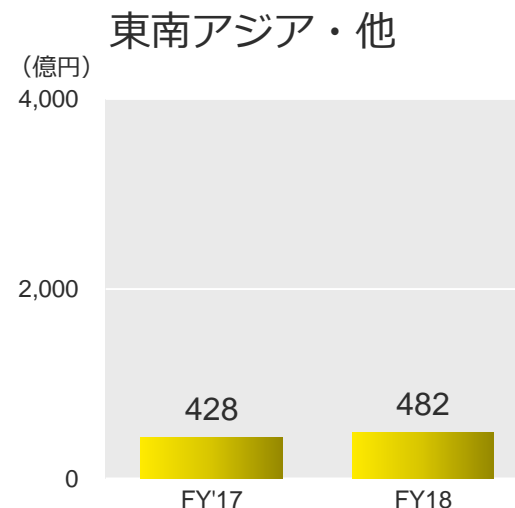
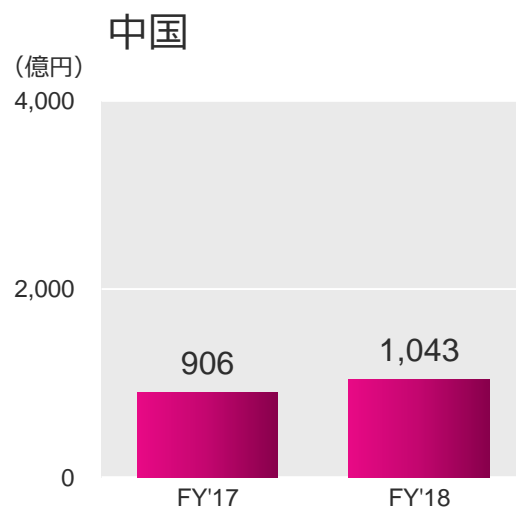
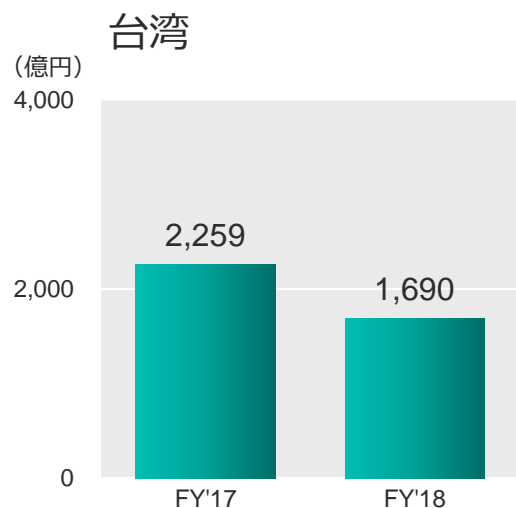
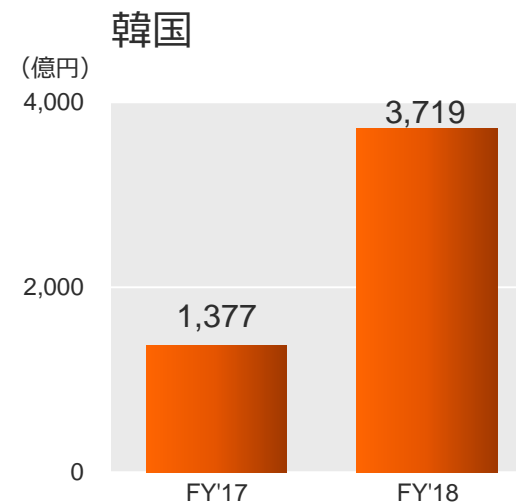
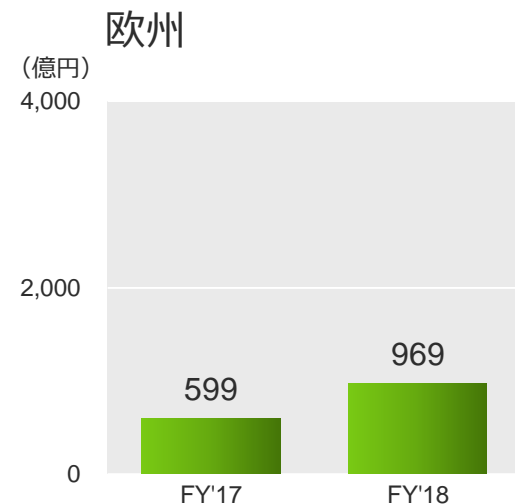
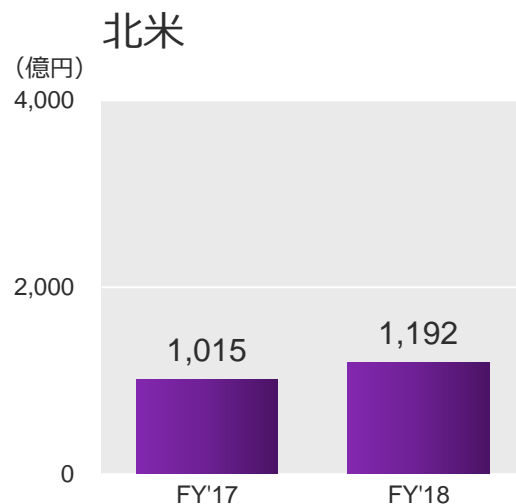
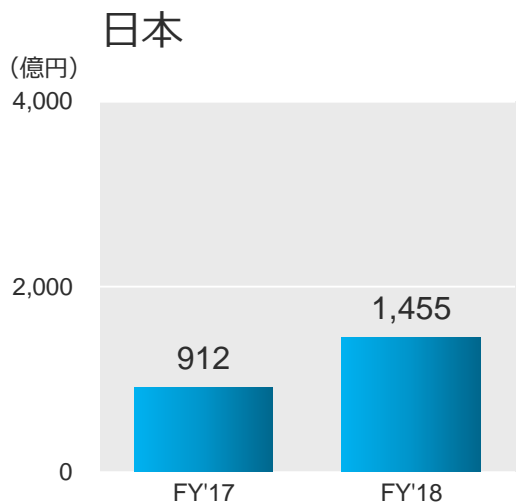
# SPE部門 地域別売上高 (四半期)

(億円)  
4,000

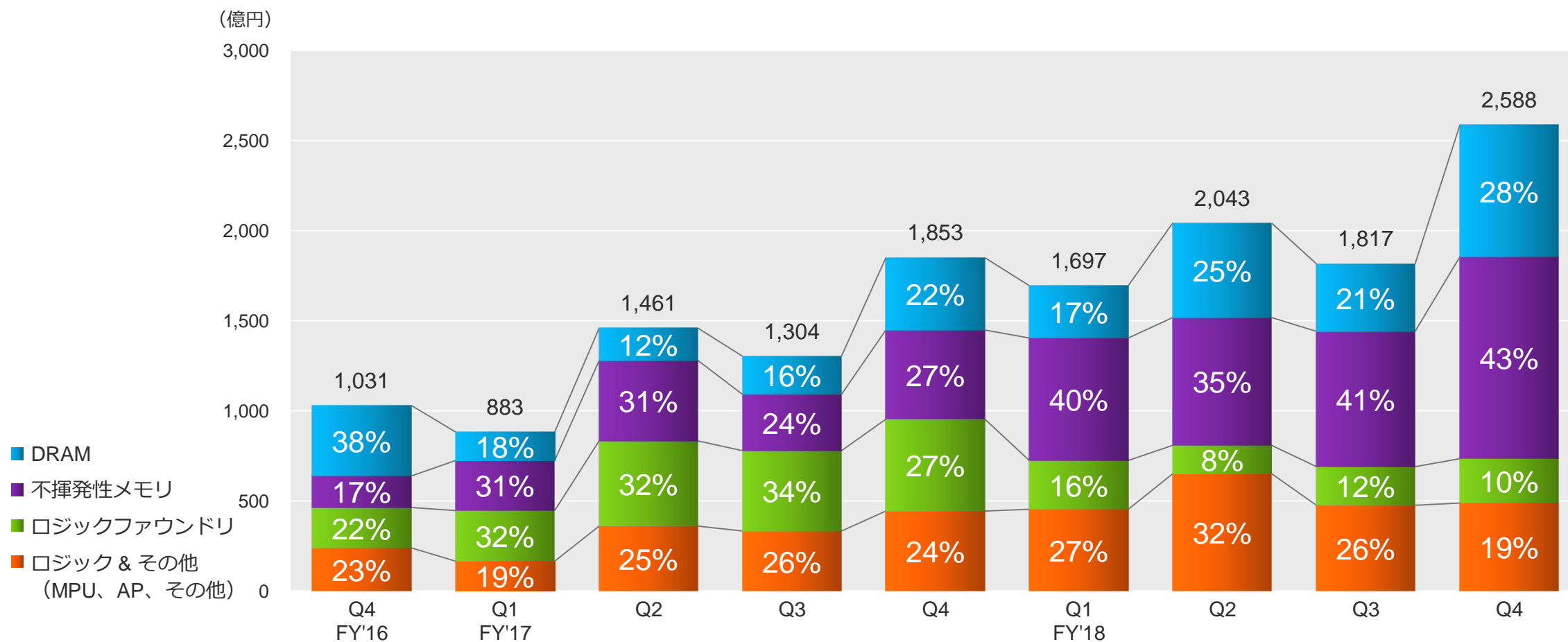


	Q4 FY'16	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4
■ 日本	264	178	264	203	266	267	384	351	451
■ 北米	197	170	344	246	254	240	320	291	339
■ 欧州	95	52	66	150	329	253	269	196	250
■ 韓国	309	198	290	333	555	683	1,017	794	1,223
■ 台湾	425	305	582	623	747	458	366	421	443
■ 中国	152	300	240	137	227	267	230	226	318
■ 東南アジア・他	50	103	173	98	53	46	67	132	234

# SPE部門 地域別売上高

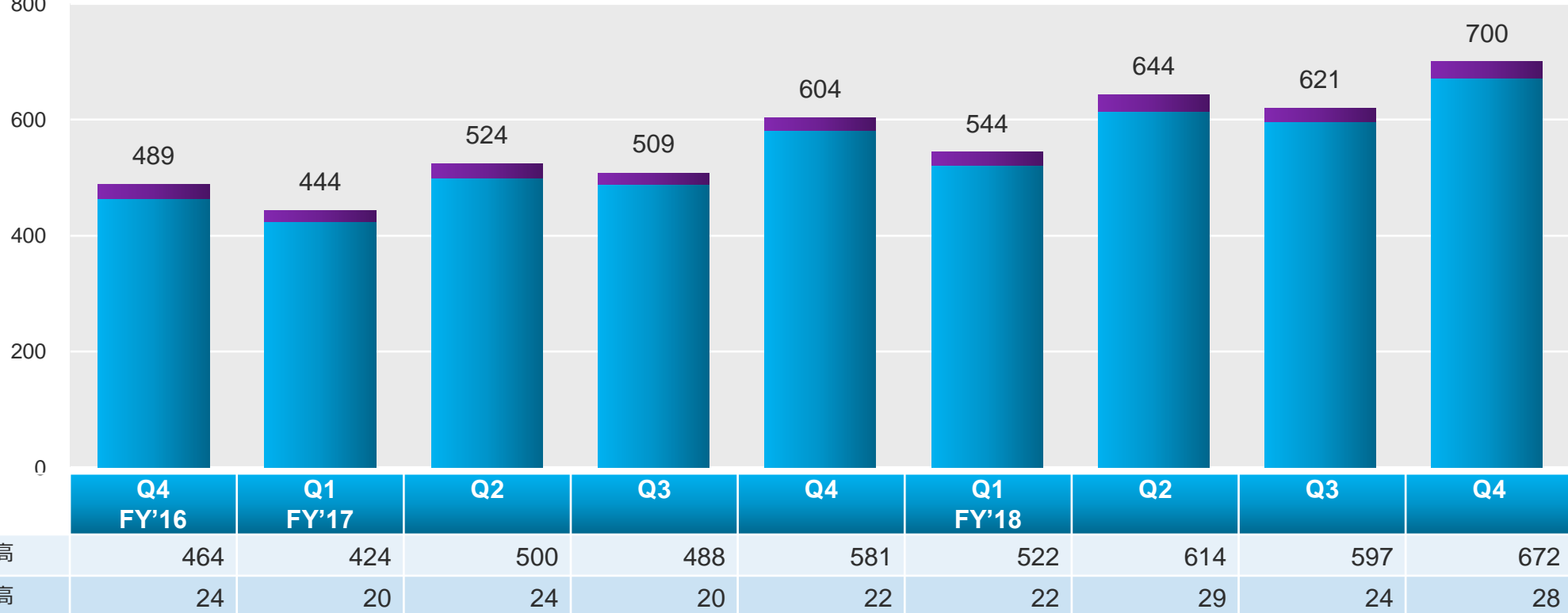


# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



# フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)





**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**